Parameter flexible Leiterplatten im Flex-Pool

Basismaterial

Leiterplatten im Flex-Pool werden aus Polyimidfolie gefertigt.
Bei 1- oder 2-lagigen flexiblen Leiterplatten beträgt die Materialstärke 0,2 mm.
Die Kupferstärke beträgt 18 µm, die Polyimiddicke 50 µm.

Eigenschaft	Polyimid
Zugbelastung	> 500 g
Biegefestigkeit	≥ 10000 Zyklen*
Kupferhaftung	≥ 0,70 N/mm²
Dielektrizitätskonstante	≤ 3,7 (1,1 GHz)
Beständigkeit im Lötbad	288°C (> 10 s)
Wasseraufnahme	≤ 3 %
Ausdehnung	± 0,20 %

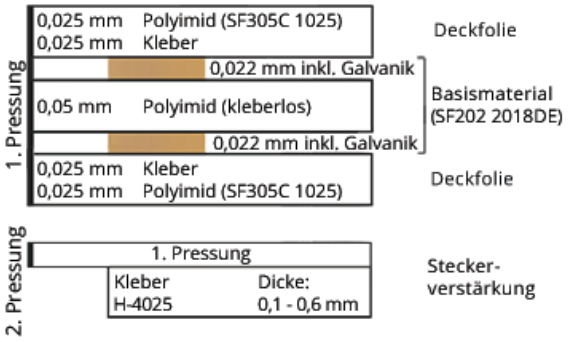
* IPC-TM 650/2.4.3

Technische Parameter

Lagenzahl	1-2
Kupfer	Einseitig oder doppelseitig
Oberfläche	ENIG
Material der Folie	Polyimid
Polyimiddicke	50 µm
Kupferdicke	18 µm
Leiterplattenstärke	0,2 mm
Max. Grösse der Leiterplatte	Länge: 400 mm Breite: 250 mm
Min. Grösse der Leiterplatte	Länge: 10 mm / Breite: 10 mm
Deckfolie	Freisparung: ≥ 200 µm
Min. Leiterbreite/Leiterabstand	125 µm
Durchkontaktierungen	Durchmesser: ≥ 200 µm
Min. Abstand Via-Via	450 µm
Min. Fräsradius	100 µm
Min. Abstand Kupfer-Kontur	200 µm
Frästoleranz	+/- 100 µm
Bestückungsdruck	beidseitig

Lagenaufbau Flex-Pool

Lagen: 2
Stärke: 0,2 mm ohne Steckerverstärkung



18.03.2019